



FEEDING EQUIPMENT
DIE EJECT UNIT

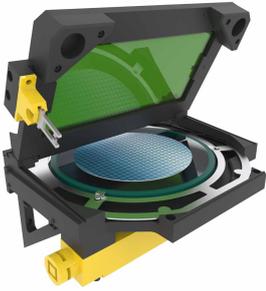
Artikelnummer: N / A
36.000,00 € – 60.000,00 € exkl. MwSt.



Kategorien: [Materialzuführung](#), [Module](#)

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Ausführung	Optionen	Preis
	S3-0086+30-0438	OurPlant X3	inkl. Waferwechsler	60.000,00 € exkl. MwSt.
	S3-0086+S3-0027	OurPlant X3	inkl. Einzelwafereinzug	36.000,00 € exkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Ausführung	Optionen	Preis
	S3-0085+S3-0027	OurPlant XTec	inkl. Einzelwafereinzug	36.000,00 € exkl. MwSt.
	S3-0085+30-0437	OurPlant XTec	inkl. Waferwechsler	60.000,00 € exkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Die Die Eject Unit löst mit ihrem Nadelsystem die auf Folie fixierten Bauteile zur Übergabe an das Bestückungssystem. Durch Austausch des manuell wechselbaren Nadelsystems und des Wafer-Frame-Adapters werden unterschiedlichste Bauteile aus bis zu 8 Zoll großen Wafern verarbeitet. Die Geschwindigkeit der Ausstechnadeln ist auf das Bestückungssystem synchronisiert und bauteilspezifisch wählbar.

Die Die Eject Unit ist inklusive einem Nadelhalter mit Deckel und Nadel (Nadel-Vakuum-System) und einem Waferadapter (wählbar) erhältlich. Durch eine spezielle optionale Adaptierungen können auch Waffle Packs auf dem Modul verarbeitet werden.

Zum automatisierten Laden der Wafer kann man zwischen einem lasersicheren Einzelwafereinzug oder einen automatischen Waferwechsler für bis zu 7 Wafer wählen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Max. Wafergröße in Zoll / mm	8 / 200
Spannung in V	24
Max. Stromstärke in A	3
Kommunikationsschnittstelle	UNICAN

